



Win-Win growth gains momentum

TOKYO SEIMITSU CO., LTD.

アニュアルレポート 2004
株式会社 東京精密

プロフィール

精密機器メーカーである東京精密は、顧客や業務パートナーとの「WIN-WIN」の関係構築による成長戦略を最大の強みとしています。当社は、将来性が高く、技術参入障壁も高い分野をターゲットとして製品群を取り揃え、技術的課題に果敢に挑戦し、それを克服することによって、半導体製造工程における中心的な分野に対応した製造装置を提供しています。私たちの挑戦の一つひとつが、半導体のさらなる進化に貢献しています。

コーポレートブランド「ACCRETECH」は、研ぎ澄まされたノウハウと最先端の技術を結集し、No.1の製品を創り出すという当社の姿勢を表しています。



目次

フィナンシャルハイライト	01	連結貸借対照表	26
株主の皆様へ	02	連結損益計算書	28
Q&A	03	連結株主持分計算書	29
営業の概況	08	連結キャッシュ・フロー計算書	30
環境への取り組み	18	連結財務諸表への注記	31
役員紹介	20	独立監査人の監査報告書	41
6年間の主要財務データ	21	ネットワーク	42
財務概況	22	インベスターインフォメーション	43

見通しに関する注意事項

このアナニュアルレポートに掲載されている東京精密の現在の計画、見通し、戦略、その他の歴史的事実ではない事柄は、将来の業績に関する見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。リスクや不確実性には、経済の動向、当社の事業領域の市況、為替変動、急速な技術革新による競争の激化などがあります。このような事象により、実際の業績はこれら見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき下さい。

フィナンシャル ハイライト

株式会社東京精密及び連結子会社

2003年及び2004年3月31日に終了した年度

	百万円		千米ドル	増減(%)
	2003	2004	2004	
会計年度:				
売上高:	¥47,171	¥ 62,324	\$590,027	32.1%
半導体製造装置	33,561	47,045	445,379	40.2
計測機器	13,610	15,279	144,647	12.3
営業利益	1,860	5,947	56,304	219.7
税金等調整前当期純利益(損失)	75	(4,064)	(38,475)	-
当期純利益(損失)	74	(3,783)	(35,821)	-
設備投資	2,333	2,904	27,495	24.5
減価償却費	2,659	2,829	26,786	6.4
研究開発費:				
半導体製造装置	3,007	5,076	48,057	68.8
計測機器	284	454	4,304	59.9
会計年度末:				
総資産	¥88,669	¥ 94,893	\$898,355	7.0
株主資本	33,645	29,183	276,279	(13.3)
		円	米ドル	増減(%)
一株当り:				
当期純利益(損失)―希薄化前	¥ 1.64	¥(101.67)	\$ (0.96)	-
年間配当額	30.00	30.00	0.28	-

注:米ドル金額は2004年3月31日における換算レート、すなわち1米ドル105円63銭で便宜上換算している。

株主の皆様へ

東京精密の業績は、当期、堅調に回復しました。この回復は、既存製品の貢献に加え、新製品が着実に成長した結果といえます。



当社は、製品が常にNo.1であり続けることを経営課題としています。No.1であるためには、お客様の抱える最も困難な問題に挑戦し、必ず解決していくことが必要です。私たちは「No.1製品であること」を常に念頭に置いて自らに問い掛けることで、他社が真似できないアイデアや技術を生み出し、半導体製造装置業界、計測機器業界で独自の地位を確立しています。

当社は、数多くのハイテク企業の中でも、技術者にとって非常に働き甲斐のある職場であると自負しています。当社には、極めて優秀な技術者が集っており、競合他社が躊躇するようなハードルの高い技術の開発に挑戦し続けています。多くの技術者が熱意と創造力の共有を求めて当社に参加し、組織の中で活躍しています。

常に「No.1製品を創る」ことを目指している経営姿勢が、当社の事業活動を独自性の高いものとしており、2003年度の業績にはその結果も表れています。ウェーハブロービングマシンは引き続きトップシェアを維持し、当社が独自に開発したプロダクトカテゴリーであるポリッシュ・グラインダは市場からの支持を獲得し、採用が拡大しています。これらが、当期最大の成果だったといえます。また、ウェーハ外観検査装置や、ウェーハダイシングマシンのシェアを拡大

させたことも当期の重要なトピックスの一つです。実際、当社は、計測機器も含めた全ての製品群において、シェアの拡大を実現しました。さらに2004年度には、新製品のCMP装置についても売上拡大を見込んでおり、LEEPL技術を駆使した新製品であるリソグラフィ装置も、近い将来に業績に貢献するものとして期待しています。

当社の競争力の高い新技術・新製品は、会社設立史上これまでになく充実しており、売上の伸びに対する新製品の貢献度は確実に拡大しています。2004年度も引き続きこの拡大基調の波に乗り続け、当社がターゲットとする全ての分野でNo.1になることを目指していきます。

2004年6月

大坪英夫

代表取締役会長CEO
大坪英夫

2003年度の業績について説明してください。また、2004年度の展望を教えてください。

Question

Answer
Answer
Answer
Answer
Answer

2003年は、世界の半導体マーケットにおいて、広範囲にわたり力強い回復が見られた年でした。今回の回復は、前回のピークの前年であった1999年当時の半導体市況と似ている部分もありますが、顕著な違いも見られます。具体的にいえば、2000年の活況が主にパソコンと携帯電話の需要に支えられていたのに対し、今回は従来の需要に加え、新たな半導体需要の牽引役としての各種デジタル家電などが普及し始めていることから、好況が前回よりも長く続くと考えています。

当社の2003年度の業績は、こういった市況の回復を反映し、売上高は前年比32.1%増の62,324百万円、営業利益は3倍以上の5,947百万円となり、ほぼ全ての製品が業績に寄与しました。ただしCMP事業とLEEPL事業について、開発関連の投資および費用などの9,772百万円を特別損失として計上したため、当期純利益は3,783百万円の損失となりました。しかしながら、CMP事業の再構築とLEEPL事業の収益体質強化により、両事業の黒字化の時期を早めることが可能になります。さらに、今回の決算では、営業活動によるキャッシュ・フローが前年

比40%以上増加して4,569百万円となり、現金及び現金同等物もほぼ倍増しました。

2004年度の業績予想としては、売上高を前年比31.6%増の82,000百万円、営業利益を135.4%増の14,000百万円、当期利益を7,600百万円と見込んでいます。半導体業界における設備投資の総額は2000年度のピーク時には及ばないものと見ていますが、当社については新製品群の貢献を織り込み、売上高、利益ともに過去最高を予想しています。ウェーハ外観検査装置、ポリッシュ・グラインダを中心に、新製品に対する需要は引き続き堅調に推移しています。CMPについても、今年は広く受容される年になるだろうと確信しています。また、既存製品に対する受注も、順調に拡大しています。



当社は、経営において一貫した基本方針を持っています。経営資源をいかに活用するかを明確に規定している当社の方針は、どのような市況下でも的確に機能してきました。その中心となっているのが「製品開発の原則」(下記参照)で、新製品開発をはじめとした当社の研究開発活動の根幹を成すものです。この原則に沿った経営を行うことで、市況の変化による影響を最小限に抑えながら、力強い成長と収益を目指しています。当社はこれまで、この「製品開発の原則」にしたがって、着実な実績を挙げてきました。今後も、この原則を遵守した経営を継続していくことによって、長期的に株主価値を向上させていきます。

「製品開発の原則」を徹底させるために、「世界No.1の製品を創ろう」というモットーを制定しました。世界No.1の製品を創るためには、最先端の技術とスピードが要求されます。つまり、長年にわたって開発してきたコア技術を結集する必要があるのです。さらに、No.1製品を創り出すためには、「WIN-WIN」の関係を構築しつつ、従業員が一丸となって働かなければなりません。当社は、「製品開発の原則」と独自

の企業風土との融合により、活気ある職場環境を創り出しています。多くの優秀な人材を惹きつけていることからわかるように、国内のハイテク産業の中で、最も働きがいのある職場の一つであると自負しています。当社には知性、情熱、ビジョンに溢れる人材が集まり、高い志をもって目標の達成を目指しています。加えて、グローバルカンパニーであり続けることも当社にとって重要な課題です。世界市場で活躍するためには、異文化を融合したグローバルかつハイブリッドな文化風土の醸成が必要となります。そこで当社は、これをモットーに組み込むことによって、「製品開発の原則」の4番目である「相応しいパートナーとアライアンスを組む」ことを可能にしています。コーポレートブランドの「ACCRETECH(アクレーテック)」は、これらの考え方をすべてを一語で表したものであり、「融合、共に成長する」という意味の“accrete”と「技術」の“technology”の合成語で、優れた技術、知恵を融合してお客様やパートナーとともに成長するという、当社の企業理念を表しています。

2

Question

今後どのようにして飛躍的な成長を実現されるのか、その戦略をお聞かせください。

製品開発の原則

1. 世界No.1の製品を創る。
マーケットシェアNo.1の商品は
(1)好況時の利益の極大化がはかれる。
(2)不況時の損失の極小化がはかれる。
2. 研究開発投資は自己資金で。
3. 開発は技術参入障壁が高く、マーケットが大きくニーズも高い分野を狙う。
4. 相応しいパートナーを見つけ、開発コストをシェアするとともに開発の成果を共有する。

過去3年間、半導体の市況が低調な時期にも、研究開発に多額の投資を行ってきました。この投資はいつから回収できると考えていますか？

3 Question

Answer
Answer
Answer
Answer
Answer

業界内でしっかりとした地位を築くためには、シェアNo.1の製品を数多く生み出すことが不可欠です。業界の中で一目置かれている企業であればこそ、一流の人材を採用することができます。また、研究開発費の自己負担を抑え、大規模かつ最先端の研究開発に携わることのできる合併や協業も可能となります。私は、No.1の製品を創る鍵となるのは、必要な情報を的確に集め、適切なタイミングで投資を行う能力だと考えています。長期的に見ると、市況が低調だからといって何もしないことが、最大のリスクです。

過去数年間の研究開発投資は、将来性の高い技術や製品分野に的を絞って進めてきました。中でも、前工程の分野で製品ラインナップを拡充できたことが最大の成果です。半導体製造工程において、より重要な分野に装置を提供することで、業界内での当社の存在感も着実に高まってきています。

ウェーハ外観検査装置やポリッシュ・グラインダについては、売上の伸長により、すでに開発資金の回収が始まっています。CMPも軌道に乗り始め、利益貢献が目前までできており、さ

らにLEEPLも近い将来、利益に貢献することが見込まれています。このような新製品の開発資金を調達したため、社債および借入金は360億円まで増加し、結果として2003年度の株主資本比率は低下しました。しかし、今後売上が伸長し収益が増加するに伴い、株主資本比率は従来の水準に回復してくると考えています。



当社は、革新的なアイデアを生み出し、それを実用化する能力により、優位性を確立し続けてきました。しかし、技術革新を成功に導く、つまり、収益性の高い製品へと結びつけるための製造インフラがなくては、真に競争力があるとはいえません。この考え方を基本として、当社では、品質と収益性を重視した製造工程の管理を行っています。

半導体産業は好不況の波が激しいのが特徴です。このため当社では、市況が低調な時期にも利益が確保できるように、柔軟性の高い生産体制の構築に常に注力しています。特に、人件費を中心とする変動費の管理にはかなりの重点を置き、契約社員の比率を高くすることで、工場内の迅速な人員調整を可能にしています。契約社員でも、短い研修を受けるだけで、ミスなく、高品質な製品が組み立てられるよう、製品設計には工夫が凝らされており、高い生産性につながっています。これらの取り組みにより、現在は、2000年度のピーク時よりも少ない人員で、当時のような夜間操業を行わずに、同レベル以上の台数を生産しています。

また、柔軟な生産ライン方式もさらに生産性を高めています。当社では一つのラインで二種類以上の製品の組み立てが可能で、製品の切り替えも短時間で行えます。現在同じラインで混流生産されているものの一例として、ウェーハプロービングマシンとウェーハダイシングマシンがあり、スペースあたりの生産台数は確実に増加しています。

コスト削減は当社の継続的な課題です。生産の効率化とリードタイムの短縮により、コスト削減目標は次々にクリアされています。また、技術部門と生産部門とが一体となって、コスト削減のために全ての製品を設計段階から見直してもいます。

東京精密は、激しいビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応し、常に高収益を維持できるように、体制を絶えず進化させ続けています。

4

Question

収益性向上のために、主に製造工程において、どのような施策を進めていますか？

株主価値の最大化を実現するためには、何が重要だと思いますか？

Question

Answer Answer Answer Answer Answer

投資家の皆様の多くは、当社の長期的な成長性を評価して株式を購入して下さっています。当社では、このような株主の皆様の期待に沿った経営を心がけております。したがって、短期的な市況や収益の変動により、方針が左右されることはありません。当社は常に長期的視野に立って戦略を立案しています。重視すべき目的は、継続的に世界No.1の製品を創り続けることにより、長期保有の株主の皆様に最大の価値をお届けすることです。当社では、一株当たり当期純利益 (EPS) を重要な経営指標としており、EPSの増大が長期的に株主価値の最大化につながると考えています。

当社の利益は、半導体業界の好不況にある程度の影響を受けることは避けられません。しかしながら、このような短期的な市況の変化で配当金を増減させることは、長期保有して下さっている株主の皆様のご期待に沿うものではないと考えています。このような考えから、当社では、将来の成長に必要な内部留保を勘案しながらも、安定した配当を継続する方針を採っています。

私たち経営陣にとって最も重要な経営課題は、株主価値を最大化することです。当社には10年以上にわたって培われた成功へのノウハウが蓄積されています。近年行われた研究開発投資はこのノウハウに基づいており、この投資が業績の向上という成果を導き出しています。さらに、市況の好調さもあり、私は東京精密の将来について、かつてないほどの確信を持っています。



半導体製造装置事業

代表取締役社長 COO 半導体社担当
鈴木貞勝



2003年度を振り返って

半導体業界は、2002年度から全般的に好転の兆しを見せ始めましたが、2003年度上期における半導体メーカー各社の設備投資は、前回の半導体不況時の経験から全般的に慎重な姿勢にとどまっていました。しかし当下期からは世界的に本格的な回復となりました。今回の半導体市況は、携帯電話、デジタルカメラ、DVDレコーダー、パソコン、薄型テレビおよび自動車向けの幅広い半導体に対する需要の伸びによって支えられています。これら製品に使われているフラッシュメモリ、CCD、CMOSセンサーなどの主要な半導体デバイスの多くは日本で開発され、生産されているものです。国内半導体メーカーは引き続き、設備投資および生産体制の増強に意欲的です。

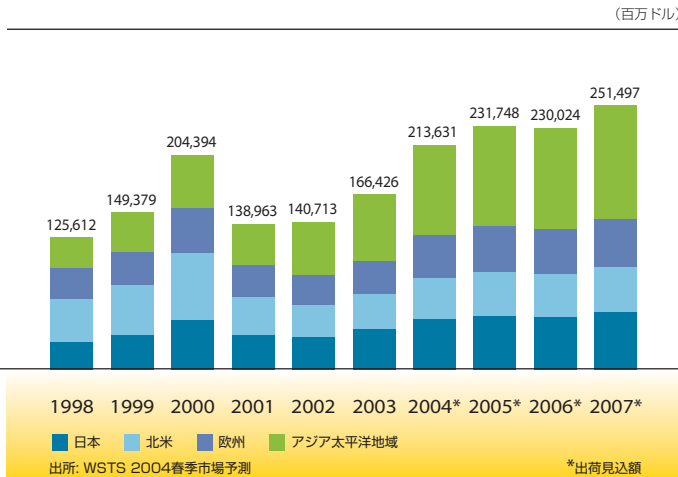
当社の半導体製造装置の受注額は、2003年後半から急速に回復し、第3四半期の受注額は、前年比で約2倍、前四半期比で76%増となりました。続く第4四半期の受注も好調で、受注額は第3四半期のさらに4%増となりました。その結果、2003年度下半期の受注額は、これまでの最高であった2000年度上半期を5%上

回り、過去最高を更新しました。特筆すべきことは、当事業の主要製品であるウェーハプロービングマシンの受注が過去最高には達していないにもかかわらず、半導体事業全体で過去最高の受注額が達成されたことです。今回、受注を牽引したのは、ウェーハダイシングマシンと、2000年度の時点では開発段階もしくは事業化されたばかりだった新製品群でした。

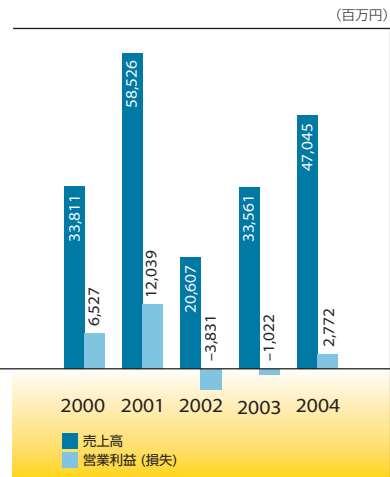
ウェーハプロービングマシン

半導体メーカー各社が200mmの生産ラインを増設する一方で、300mmラインに積極的な設備投資を行ったことにより、プロービングマシンの2003年度の売上は、前年比約40%増となりました。受注額は急増しており、特に2003年10月以降にその動きが顕著になりました。プロービングマシンの月次生産台数は、2004年3月には2003年10月の3倍以上に増加しました。この伸びの背景には、いくつかの要因が重なっています。まず、半導体メーカー各社が増産体制に移行し始めたことです。これにより、国内の半導体関連産業が一斉に上向きはじめました。また、薄型テレビを

半導体生産高
(12月31日に終了した暦年度)



売上高／営業利益(損失)
(3月31日に終了した事業年度)



はじめとしたデジタル家電の売上が拡大したことが、半導体の需要を牽引しました。地域別では、日本、韓国、台湾のメーカーからの引き合いが、売上増加分の大半を占めています。

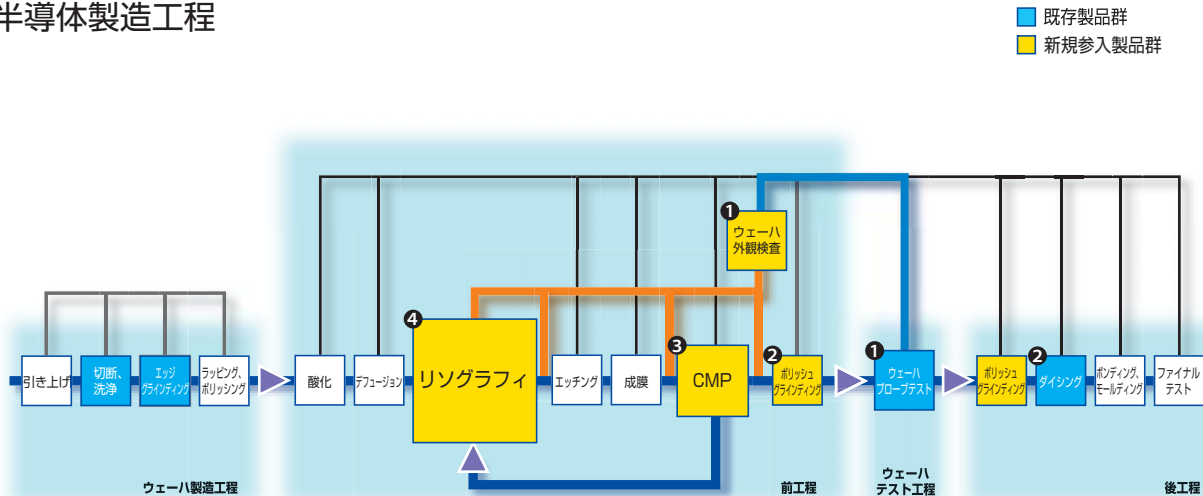
当社は、半導体需要が拡大する好機をとらえ、世界市場においてリーディングポジションを確立しているプロービングマシンのさらなるシェア拡大に努めました。当社がプロービングマシンで確固たる地位を維持しているのは、幅広い既存顧客の基盤があることに加え、台湾のテストハウスなどにおいて絶大なシェアを確保しているためです。さらに、今後大きく成長が見込まれる300mmウェーハの重要な市場でシェアを伸ばしたことも、これに貢献しました。2004年度はさらにプロービングマシン市場が伸びると予想されているため、増産体制を整備すると同時に、生産性と収益性向上に努め、2000年度以上の実績を挙げることを目指していきます。

ウェーハダイシングマシン

2003年度の売上は、前年比で約50%増となり、2000年度のピーク時の約90%まで回復しました。受注額は、2000年度のピークを上回り、過去最高を記録しました。このような大幅な受注増をもたらしたのは、お客様が抱えているニーズを的確に捉えることができたからです。半導体メーカーは、300mm向けの投資を行うとともに、さらなる精度向上を目指して設備投資を拡大しています。このような中、既存のお客様からまとまった発注をいただいたことや、数社と新たに取引を開始したことが、シェア拡大に寄与しました。また、ウェーハを薄片化するポリリッシュ・グラインダを半導体メーカーが導入するにあたり、高精度のダイシングマシンが必要となるため、相乗効果でダイシングマシンの受注が増加しました。このような状況から、2004年度の売上と受注額は過去最高を更新すると予想しており、また収益性に関して2000年度のピーク時と同等またはそれ以上のレベルに向上させる予定です。

当社は、浜松ホトニクス(株)と共同で、ブレードを使わない全く新しいダイシングマシン「MAHOHDICING

半導体製造工程



MACHINE]を開発しました。このダイシングマシンは、独自のレーザー技術を採用し、内部にレーザーを照射して改質層を形成させながらウェーハをチップに分割する装置です。この装置は、非接触で物理的ストレスをかけずに分割するとともに、薄型単結晶ウェーハでも表面にダメージを与えることなく分割が可能です。また、ブレードを使わないため、完全ドライプロセスを実現しました。このため、薄物ウェーハやCCDなどドライ加工が必要なデバイスや、Low-Kウェーハなど従来のブレードダイシングマシンでは困難であったウェーハの分割に適しています。「MAHOHDICING MACHINE」の試作機に対し、お客様から高い評価を得たことから、実際に生産ラインで使用できる段階に進んでいます。将来性の高い製品ではあるものの、この装置の導入には半導体の製造工程自体の変更を必要とするため、本格的な普及には多少時間を要するものと見ていますが、2004年度から売上に貢献してくると予想しています。

ウェーハ外観検査装置

日本、韓国、台湾、ヨーロッパにおいて300mmウェーハ対応の高精度モデルの受注が増加したことが寄与し、ウェーハ外観検査装置の売上は、前年比で約50%増加しました。また2004年度中には、中国でもウェーハ外観検査装置の販売を開始する予定です。

主要製品である「WIN-WIN 50」シリーズは、安定したリピートオーダーに加え、新規のお客様を着実に増やしていることから、継続してシェアを拡大しています。この装置の強みの一つは、コスト・オブ・オーナーシップ(CoO)の低さにあります。半導体の微細化が進み、検査装置のCoOは一般的に増加傾向にあります。しかし当社は、お客様との「Win-Win」の関係の構築をモットーに、コスト抑制のためのさまざまな機能をこの装置に搭載しています。例えば、導入した装置を工場内でユニット交換するだけで新モデルにバージョンアップできる「フィールドアップグレード」機能の採用があります。このほかの特長としては、高解像度を実現する共焦点顕微鏡の採用による高い欠陥検出率や、半導体製造工程の中で唯一やり直しが効くレジ

既存製品 ①

ウェーハプロービングマシン「UF3000」

ウェーハプロービングマシンは、ウェーハ上に形成された半導体チップの電気性能テストを行う装置であり、半導体の品質管理において欠かせない装置です。当社のプロービングマシンは、VLSIリサーチ社の半導体製造装置顧客満足度調査「10BEST賞」を、テスト&ハンドラ部門において9年連続で受賞しました。



既存製品 ②

ウェーハダイシングマシン「A-WD-300T」

ウェーハダイシングマシンは、ウェーハ上に形成された多数の半導体チップを一つひとつのチップに分割する装置です。当社のダイシングマシンは、VLSIリサーチ社の「10BEST賞」のアセンブリ部門で、昨年に引き続き第一位を獲得しました。

スト工程での欠陥検出率を向上したことなどが挙げられます。

2004年4月に販売を開始した「WIN-WIN 50 1400」は、65nmデザインノードに対応したウェーハ外観検査装置です。この装置は、複雑なウェーハ構造でも高感度で欠陥検出が可能です。さらに、この新製品の画像処理速度は、「WIN-WIN 50 1200」と比較して40%向上しています。当社は、「WIN-WIN 50 1400」の優れた搭載機能を強みに、ウェーハ外観検査装置市場でさらなるシェアの拡大を図る計画です。この装置は発売当初より、国内外のお客様から高い評価をいただいています。日本をはじめとする東アジアにおいて設備投資が活発になれば、販売台数の増加が見込めます。

さらに、お客様の幅広いニーズに応えるため、(株)日立ハイテクノロジーズと共同で、「HA-3000」を開発し、日立ハイテクノロジーズブランドにより販売しています。この装置は、遠紫外光(DUV: Deep Ultra Violet)の採用で解像度を高め、さらに画像処理スピードの向上により欠陥検査の効率化を実現した装置です。

ポリッシュ・グラインダ

ウェーハの薄片化市場は順調に拡大しました。当社のポリッシュ・グラインダはデファクトスタンダード化していることから、当事業の2003年度の売上高は、前年比2倍以上となりました。日本、韓国、台湾での需要が大きく伸びましたが、米国、欧州での需要の伸びも業績に貢献しています。カメラ付携帯電話とデジタルカメラの普及がウェーハの薄片化の需要を牽引しています。これらの複合製品は小型・軽量化が進んでおり、三次元実装技術などの最先端のパッケージ技術と同時に、多機能化、高速化を実現する半導体デバイスを必要としています。こういった需要に対応するためにも、ウェーハの薄片化に対するニーズはますます強くなってきています。

2003年度に最も売れた製品は、「PG300RM」でした。この装置は、ウェーハの裏面研削とダメージ層の除去という2つの機能を同一テーブル上で行うだけでなく、接続したRMユニットにより、ウェーハ表面の保護テープの除去およびダイシングフレームへのマウントの2つの機能を追加し、合計4つの機能を充足させ

新規参入製品 ①**ウェーハ外観検査装置「WIN-WIN 50 1400」**

ウェーハ外観検査装置は、回路のパターンが転写されたウェーハ表面の異物やパターン欠陥などを検出する装置で、半導体の歩留り向上に必要な装置です。「WIN-WIN 50 1400」は、従来比40%まで向上した画像処理速度や、複雑なデバイス構造に適した高感度などにより、65nmノードまでの半導体プロセスに対応しています。

**新規参入製品 ②****ポリッシュ・グラインダ「PG300RM」**

ポリッシュ・グラインダは、ICチップや三次元実装技術に必要とされる薄くて剛性の高いウェーハを実現する装置で、ウェーハの裏面を研削すると同時にダメージ層を除去できる世界唯一の装置です。「PG300RM」は、現在PGシリーズの主流モデルで、上記の2つの機能に加え、表面テープの剥離からダイシングフレームへの取り付けまでの計4つの機能を一台で可能にします。

た300mmウェーハ用の装置です。さらに、薄片化に伴い、ダイアタッチフィルムも脚光を浴びはじめ、当装置はダイアタッチフィルムの貼り付け機能をお客様の要望に応じて追加することが可能です。今後、ウェーハの薄片化の需要が大きく拡大すると見込まれる中で、ポリッシュ・グラインダでさらに売上の拡大と収益性の向上を図ります。

CMP

CMPの売上高は前年とほぼ同水準でしたが、既存のお客様からのリピートオーダーや新規顧客からの受注、さらに300mmライン向けの受注を得たことが、受注額を前年比で2倍以上に押し上げました。この装置は、独自のエアフロートキャリアをはじめとした際立ったデザインコンセプトと構造設計により、優れた性能を発揮しています。単層パッドを採用し、ウェーハの表面の平坦度をより高め、ウェーハの有効領域を拡大したことも差別化につながる特徴となっています。さらに、ユーザーの生産性向上と、メンテナンスコストの削減にも貢献する装置です。もうひとつの特

長は、この装置は最先端の半導体デバイス生産に不可欠なLow-KやCuダマシンに完全に対応していることです。新しいカテゴリーであり、技術改良の余地が比較的大きいCMP市場で、これらの独自技術を搭載した装置の提供を行うことにより、シェアの拡大に努めています。

2004年度には、300mmの新設ラインの竣工が多数予定されており、CMPIに対する需要の拡大が見込まれます。当社は、この好機を活かし、既存のお客様との関係を強化すると同時に、より多くの新規のお客様からの受注獲得に努めていきます。

LEEPL

LEEPL (Low Energy E-beam Proximity Projection Lithography : 「低加速電圧電子ビーム近接投影露光」の略)は、半導体デバイスの設計を根底から変革する画期的技術であることが認められ、半導体メーカーから高い評価を受けています。LEEPL技術の認知度をさらに高めるために、また開発を促進するために、技術コンソーシアムが結成されており、半導体メーカー、

新規参入製品 ③

CMP「A-FP-310A」

CMPはウェーハ表面の凹凸を平坦化する装置で、半導体デバイスの多層化や、配線材料の多様化に伴い、用途が拡大しています。「A-FP-310A」は、独自のエアフロート式ヘッドの採用により、優れた均一性、低圧研磨の安定性など高いプロセス性能を持った装置です。



新規参入製品 ④

リソグラフィ装置「LEEPL-3000」

リソグラフィ装置は、ウェーハ上に半導体回路のパターンを転写するための装置で、前工程の中核的存在です。「LEEPL-3000」は全く新しいコンセプトの画期的な電子ビームリソグラフィ装置です。

マスクメーカー、マスクインフラメーカー、レジストメーカーから計32社が参画しています。

ArF光源を使った従来の光学系リソグラフィ装置では不可能な、狭ピッチ微細パターンの転写が、LEEPLでは可能となることが実証されています。当社は、非常に高度な技術である微細なコンタクトホールの転写がLEEPLによって可能となることが、広く業界に認知されるよう努めています。すでに複数の半導体メーカーが半導体デバイスパターンでの評価を開始しています。当初はコンタクトホールの転写技術の優位性によってお客様にご採用いただき、その後LEEPL技術のアプリケーションを広げていく計画です。

さらに当社では、マスクインフラ設備の一つであり、検出率と検出速度の高さを特長とするステンシルマスク欠陥検査装置EBSscanner「ESMI 3000」を製造しています。

競争力向上のために

当社は、競争力向上のため、技術面・生産面でさまざまな施策を実施しています。

まず技術面では、当社装置の性能を向上させることにより、お使いいただいているお客様のCoO削減の貢献に努めています。

また製造面においては、社内で多くのコスト削減策を推進し、特にプロービングマシン、ダイシングマシンなどの既存製品群において大きな成果を得ています。今後予想される厳しい事業環境下においても、収益性や機動性を維持できるよう、さらに高い目標を設定し、その達成を目指していきます。

計測機器事業

代表取締役 COO 計測社担当
藤森一雄



2003年度を振り返って

計測機器事業は、国内景気が回復してきたことにより、前年度に引き続き堅調に推移しました。売上高は前年比12.3%増加の15,279百万円、営業利益は10.1%増加の3,174百万円となり、当事業の営業利益率は20%台を維持しました。特に、自動車業界の計測機器に対する需要の伸びが顕著でしたが、これは主に国内自動車メーカーの海外における設備投資に伴うものでした。今後も自動車業界からの受注は引き続き増加すると期待しています。また、デジタル家電やベアリングメーカーからの引き合いが増加したことも業績の伸長に寄与しました。さらに、金型メーカーなどからの需要も増大しています。

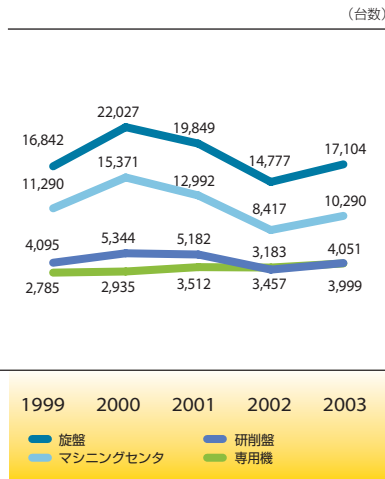
計測機器事業における他社との協業は、当事業を構成する重要な要素の一つとなっています。子会社の(株)東精エンジニアリングでは、当社が販売する自動計測機器の開発、製造、サービスを行っています。汎用計測機器に関しては、当社が開発、製造、販売を担当し、東精エンジニアリングがアフターサービスを主に担当しています。また汎用計測機器事業において

1995年から提携しているカールツァイス社との関係は、当社のモットーである「Win-Win」の関係の構築を具現化している好例となっています。カールツァイス社が三次元座標測定機を担当し、当社が表面粗さ・輪郭形状測定機および真円度測定機を開発、製造しています。グローバルな販売分担については、各地域において強いブランド力を持つ方が、その地域での販売を担当しています。

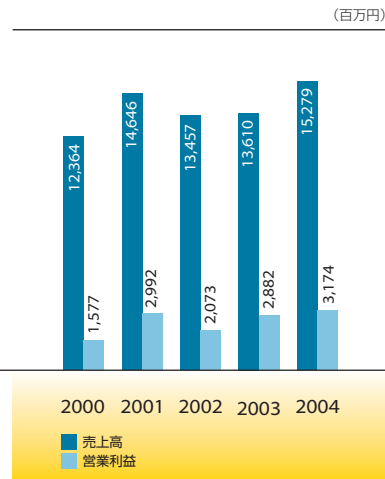
世界市場で成長機会を捉える

当事業は日本を主要市場としていますが、今後の当社の業績には、中国やインドを含むアジア地域が大きく貢献してくると予想されています。すでに2003年度に、中国での計測機器の売上が飛躍的に伸びています。また、北米や欧州市場における需要の伸びも期待されています。当事業では、2005年度末時点で海外比率を20%以上に引き上げることを目標としています。海外売上拡大のために、海外での営業力の強化とサービス拠点の拡充、さらに営業技術部門の強化や、カールツァイス社とのより綿密な連携などを推進して

工作機械生産台数
(12月31日に終了した暦年度)



売上高／営業利益
(3月31日に終了した事業年度)



います。一例を挙げれば、現在東南アジアでは、カールツァイス社が汎用計測機器の販売を行っていますが、現地に工場を有する日本メーカーのニーズにもとづいた提案は当社が行っています。また北米や欧州では、既に確固たる地位を確立しているカールツァイス社の協力を得ながらACCRETECHブランドの製品の売上を伸ばしていきます。

さらに東南アジアにおける拡販を進めるために、東精エンジニアリングは2004年2月に自動計測製品のサービス拠点としてTosei(Thailand)Co.,Ltd.を設立しました。同社はマシンコントロールゲージおよび自動測定機のスペアパーツなども揃えています。現在タイでは、メーカーの生産拠点が急激に増えており、事業機会の大きい市場として期待されています。Tosei(Thailand)の設立により、東南アジアにおいて、高性能・高品質の自動計測機器メーカーとしてお客様の信頼を獲得し、確固たる地位の確立につなげていきます。

汎用計測機器事業

三次元座標測定機は、汎用計測分野において大きな比重を占めており、工場などで必要な検査工程を行う計測機器として、特に品質管理面で重要な役割を果たしています。精度の高い三次元座標測定機を提供している当社は、カールツァイス社と協業しながら当市場において業容の拡大を継続しています。国内では、カールツァイス社製の三次元座標測定機の販売が好調です。特に同社と共同で開発した、国内でニーズの高い普及機の売上は順調に推移しています。

こうした当社とカールツァイス社の協業の具体例としては、2003年4月に販売を開始している三次元座標測定機「ザイザックスSVA」が挙げられます。同製品は、カールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した、お客様のニーズに合った製品として多様な業界から高い評価を得ています。販売台数は、初年度で200台以上となり、三次元座標測定機の一つの製品シリーズでの初年度の販売台数としては、過去最高の実績をあげました。さらに2004年4月には、新製品「ザイザックスSVA fusion」の販売を開始

三次元座標測定機「ザイザックスSVA fusion」

三次元座標測定機は、サブミクロンから5ミクロン程度までの精度で三次元の寸法を測定します。「ザイザックスSVA fusion」は、東京精密の高剛性技術を活かしたハードウェアに、カールツァイスのセンシング技術による高精度アクティブスキャン方式プローブを搭載した、本格的な装置です。自動車から家電製品まで、幅広い用途に使われています。

**真円度測定機「ロンコム75GB」**

真円度測定機は、円型部品の形状をサブミクロンレベルの精度で測定します。「ロンコム75GB」は測定箇所的位置決めから測定データの作成まで完全無人化を実現しており、自動車のピストン、クランクシャフトやカムの穴、プリンターのヘッド、コピー機のドラムなどの測定に用いられています。

し、「ザイザックス」シリーズの評価を高めています。この機器は、高スピード、高精度への高まるニーズを同時に実現するカールツァイス社のアクティブスキャン技術を搭載した製品です。この新機種の投入により、「ザイザックス」シリーズは2004年度においても売上の拡大が見込まれています。

カールツァイス社製の三次元座標測定機「PRISMO」シリーズもまた、お客様の生産性向上に貢献する製品です。高精度、高スピードの測定機能を併せ持つ「PRISMO」は、国内で高い評価を得ています。温度変化や振動、塵・埃の影響を受けにくい計測機であり、また、特別な知識がなくても簡単に操作ができることも大きな特長です。

表面粗さ・輪郭形状測定機の分野では、2003年4月に販売を開始した「サーフコム1500DX」「コンターレコード1700DX」もまた好調に売上を伸ばしました。表面粗さ形状測定機「サーフコム1500DX」は、リニアモータを採用し、世界最高レベルの測定スピードと低振動を実現しています。また、輪郭形状測定機「コンターレコード1700DX」も同じくリニアモータを採用

し、競合製品を凌駕する精度と測定速度を併せ持つ、優れた製品です。表面粗さ・輪郭形状測定機事業は、2004年度も引き続き好調が予想されています。設備投資の堅調さに加え、自動車業界を中心とした国内メーカーが表面粗さに関する新しい規格(JIS2001)を採用する予定であることが、計測機器の買い替え需要を後押しするものと期待しています。

真円度測定機「ロンコム」シリーズも、精度の高さと耐久性がユーザーから高く評価され、好調でした。「ロンコム」シリーズは、10nmの精度で真円度測定を行うため、エアベアリングを利用した超高精度回転テーブルを搭載しています。活発な自動車産業の設備投資を反映し、「ロンコム70」シリーズなど大型機の売上が伸長しました。この傾向は、2004年度に入っても継続しています。

自動計測機器事業

自動車産業の設備投資が活発であったことを反映し、お客様の仕様に合わせたモデルを中心に受注が増加したことにより、自動計測機器の売上は国内外

表面粗さ形状測定機「サーフコム1500DX」

表面粗さ形状測定機は、ものの表面の状態および形状を、ナノメートルから数十ミクロンまでの精度で測定します。リニアモータ搭載の「サーフコム1500DX」は、世界最高レベルの測定スピードと低振動を実現しており、自動車部品、工作機械など精密機器関連部品のメーカーで幅広く採用されています。



「ATC振れ検出システム」

ATC振れ検出システムは、ツールテーパー部への切り粉の噛みこみなどによって生じる加工不良を防止する、世界で唯一の画期的な装置です。ミニマムな測定時間で検出を行うため、全点検査を可能にし、製品の品質向上に貢献します。

で伸ばしました。高速で効率的な測定が可能なマシンコントロールゲージの「フレックス・フィンガ」は、優れた操作性と価格優位性が高く評価され、売上を伸ばしました。また、マシンコントロールゲージ管制部の「パルコムV」シリーズも順調に売上を伸ばしました。5年前より開発・販売されている本シリーズは、量産部品を加工途中または加工後に全数検査を行う装置で、品質管理に欠かせない役割を果たしています。ベアリング、エンジンやトランスミッション部品、ギア、シャフトの測定に使われています。また新製品「ATC振れ検出システム」も市場から高く評価されており、アルミ部材を加工しているメーカーのマシニングセンターなどを中心として、多くのお客様の生産現場で標準採用され始めました。

継続的な品質および顧客満足度の向上のために

当社は、2003年より、顧客満足度向上を実現するために、新規および当社の計測機器購入後一年を経過した全てのお客様を対象に、「品質」「コスト」「納期」「アフターサービス」に関するアンケートを実施しています。

アンケート結果は、製造・技術・営業など関係部署に配布され、各々の立場で改善を実施しています。

また、生産方法の改善および営業と製造部の連携強化により、生産の効率化と短納期化を推進しました。具体的には、作業の標準化を進め、契約社員でも簡単かつ正確に組み立て作業を行えるようにしました。さらに、製品設計の段階からのコスト削減も推進しています。当社は、各製品の市場価格を基準に原価目標を設定しています。これらの施策により、当社の計測機器事業は成長を継続し、利益を拡大できる体制の構築を進めています。

地球環境との「WIN-WIN」の関係を実現するために、東京精密は環境にやさしい事業活動の実現に努めています。

1. 基本理念

当社は、地球環境保全が人類共通の重要課題であることを認識し、生産・サービスの全域において積極的に環境保全に配慮した行動をとる。

2. 環境保全活動の沿革

1996年7月	環境保全活動の教育訓練を開始
1996年9月	環境管理委員会を設立
1997年2月	環境負荷調査を八王子・土浦の両工場および各部署で開始
1997年5月	環境管理マニュアルを制定
1998年3月	ISO14001承認を両工場において取得
2001年4月	ISO14001承認を更新
2003年3月	「グリーン調達ガイドライン」を制定



3. 環境保全活動の基本方針

環境保全活動の基本方針は、全従業員が、生産からサービスまで全ビジネス領域において、常に「この行動は地球に優しいか」を配慮し、環境負荷を可能な限り少なくする努力をすることです。当社では、環境管理委員会が中心となって環境管理体制を組織し、環境関連の法律、条令、協定および当社の「環境方針」を遵守し、環境保全活動を推進しています。当社で制定した自主目標ならびに内部監査の指摘により見直しを行っている分野は以下の通りです。

- 省エネルギー・省資源・廃棄物の削減・リサイクルへの取り組み、天然資源の有効利用
- 有害物質の適正管理による汚染の予防、環境負荷の高い物質の使用量削減(代替物質への転換など)
- 環境に配慮した新製品の開発および既存製品の改良(省エネルギー・省資源・有害物質の不使用など)

全社員に対し環境保全に関する教育普及を行い、意識の向上を図っています。また協力会社の工場に対しても当社の環境保全活動への理解が得られるよう努力しています。

4. 現状における主要活動

東京精密は、当社製品に使用する部品の選定や、お客様に納入する装置の仕様決定において、環境負荷の低減を念頭に置いています。このほかにも、環境会計の導入、天然資源の有効利用などの対策を推進しています。

当社では、2002年11月の環境管理委員会において、以下を決定し、これらを現在積極的に推進しています。

- 全製品においてグリーン調達に取り組むこと
- 2006年出荷製品までにRoHS指令*で規制された物質を含む特定した物質の含有を禁止または削減の処置をとること

5. グリーン調達への取り組み

グリーン調達とは、(1)環境管理体制が整った取引先から、(2)環境負荷の少ない部材を、優先的に調達することと考えます。環境管理体制が整った取引先とは、ISO14001もしくはISO14001に準ずる独自の環境管理システムによって管理している取引先です。また、環境負荷の少ない部材とは、環境影響物質、省エネ・省資源設計、梱包・輸送等への環境的配慮がされていることです。環境管理委員会は、当社のグリーン調達に対する姿勢についてまとめた「グリーン調達ガ

イドライン]を作成し、このガイドラインに沿った、環境への意識の高いサプライヤーを優先的に採用することによって環境保全に貢献しています。同時に、特定した化学物質が、取引先の製品の部材中にどのような形で含有/使用されているかについてアンケート調査も行いました。さらに、当社で作成した評価基準にもとづいて取引先への詳細な調査を行い、結果をデータベース化して、2004年5月からグリーン調達を開始しました。

6. 特定化学物質の含有禁止／削減

グリーン調達における含有禁止／削減物質の特定は、ユーザーの規律をもとに上記のアンケート結果をふまえて当社で決定しています。

特に、RoHS指令で規制された6物質については、既に、技術／コスト面からの検討を開始しており、これらの結果は図面作成および取引先選定に反映していく計画です。現状の各課題への取り組みは以下のとおりです。

□ 鉛フリー化

2004年度に鉛フリー基板の評価を行い、2005年度中の鉛フリー化を目指します。

□ 六価クロムフリー化

図面で有色クロメートを指示している部品を洗い出し、他のメッキへの変更もしくは抜本的な材質変更の可能性、コストへの影響について調査を実施中です。

□ カドミウム、水銀、PBB、PBDE のフリー化含有部品の調査を実施中です。

上記の方策を推進し、計画では、2005年度の半ばまでには、「6物質の含有禁止」を完了する予定です。

RoHS指令について

RoHSは"Restriction of the use of certain Hazardous Substances"の略です。2006年7月以降、EU域内において、電気・電子機器への有害物質(水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、PBB、PBDEの6種類)の使用が禁止されるというものです。対象となる範囲は、大型家電、小型家電、情報技術および通信機器、消費者向け電子機器、照明機器、電動・電子工具、玩具、レジャー・スポーツ用具、自動販売機等と幅広く、今後、EU加盟各国は、この指令をもとに、2004年8月までに国内法制化をすすめることとなります。本指令は、製品中の物質使用に関する規制であるため、

1. 部品メーカーや材料メーカーに至るまで広範囲に影響が及ぶ
2. 各メーカーに開発・設計段階からの早期対応を求めている

といった性質を持っています。EUに輸出を行ったり、EUにおいて生産・販売を行ったりしている企業にとって、ビジネス継続のために克服しなければならない課題です。

7. グリーンプロダクツ活動の今後の展開

当社では、従来、商品をQ(品質)・C(コスト)・D(納期)で評価していましたが、現在では「Q C D + E(環境)」がその真価を決めるといわれています。特に環境負荷が大きいとされる半導体製造装置事業においては、積極的に環境配慮設計に取り組み、LCA(ライフサイクルアセスメント)を実施し、省エネルギー(装置本体だけでなく付帯するユーティリティも含む)、省資源(純水の削減などを含む)、有害化学物質の削減などを達成することが、製品の生き残りに不可欠となっています。

グリーン調達をはじめとするグリーンプロダクツ実現への活動は、当社のすべての製品において実施されています。

役員紹介



左から：太田 邦正、鈴木 貞勝、大坪 英夫、藤森 一雄、長澤 英二

代表取締役会長CEO

大坪 英夫

代表取締役社長COO

鈴木 貞勝

代表取締役

藤森 一雄

長澤 英二

太田 邦正

取締役

西嶋 尚生

梅中 茂

高城 英明

ウォルフガンク ボナッツ

グレッグ セバスチャン

監査役

吉儀 肇

軽部 昭三郎

小倉 利之

山本 清次

(2004年6月29日現在)

6年間の主要財務データ

株式会社東京精密及び連結子会社
3月31日

						百万円	千米ドル
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2004
会計年度：							
売上高	¥32,153	¥46,176	¥73,172	¥34,064	¥47,171	¥62,324	\$590,027
営業利益(損失)	1,621	8,104	15,032	(1,757)	1,860	5,947	56,304
当期純利益(損失)	715	4,422	7,237	(2,026)	74	(3,783)	(35,821)
会計年度末：							
総資産	41,309	61,007	91,477	79,865	88,669	94,893	898,355
株主資本	28,437	33,433	38,779	35,423	33,645	29,183	276,279
有利子負債	1,383	4,328	17,522	31,145	33,531	36,253	343,207
						円	米ドル
一株当り：							
当期純利益(損失) — 希薄化前	¥19.41	¥118.43	¥192.95	¥(54.21)	¥1.64	¥(101.67)	\$(0.96)
— 希薄化後	19.15	117.95	192.21	—	1.64	—	—
従業員数(人)	1,057	1,068	1,160	1,146	1,101	1,100	

財務概況

概況

当社は、半導体製造装置および計測機器のメーカーです。これらの事業はいずれも、市場の変化が激しく、常に最新技術が要求されます。こうした環境下、当社が持続的な成長を続けていくためには、適正な基準に準拠した製品開発を、強力な体制で行っていくことが重要となります。そのため、独自の「製品開発の原則」に沿った経営を行うことにより、市場の設備投資動向による影響を最小限に抑えながら、高成長・高収益なビジネス基盤を構築しています。

当社は、対処すべき課題として、財務状態の改善を掲げています。2001年度のシリコンサイクルの落ち込みは、フローバの在庫および新製品関連資産の増加を招き、結果として財務諸比率が低下しました。しかし、フローバの在庫増は2002年度で解消し、新製品も2003年度において着実に売上が増加したため、資産回転率は大幅に改善しました。また当社は、2003年度下期に、今後の収益基盤を一層拡充するために、CMP事業の再構築とLEEPL事業の収益体質強化を実施し、特別損失9,772百万円を計上しました。

新製品群の販売が拡大している成長期の当社の場合、今後1～2年の財務諸比率の改善は緩やかなレベルに留まります。しかし数年後には、新製品群の売上・利益への貢献によるフリー・キャッシュ・フローのプラスが生まれ、さらに昨年10月に発行した転換社債型新株予約権付社債が資本へと転換されるため、財務諸比率が格段に改善される見通しです。

売上高

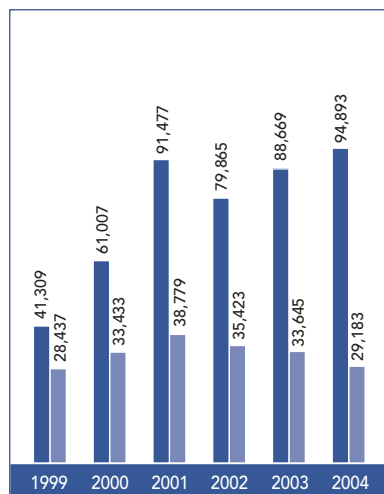
2003年度の売上高は、前年比32.1%増の62,324百万円と大幅に増加しました。

半導体業界は、パソコンの需要回復やカメラ付携帯電話の普及に加え、デジタル家電が好調に推移したことにより、2002年度後半から回復基調を見せていましたが、2003年度下期からは本格的な回復を果たしました。半導体メーカーの設備投資も、2003年度上期は慎重さが目立ったものの、下期は極めて積極的に推移しました。これを反映して、当社の半導体製造装置部門の受注・売上は、下期以降急回復し、既存製品・新規参入製品とも好調でした。最終的に、売上高は、前年比40.2%増の47,045百万円となりました。

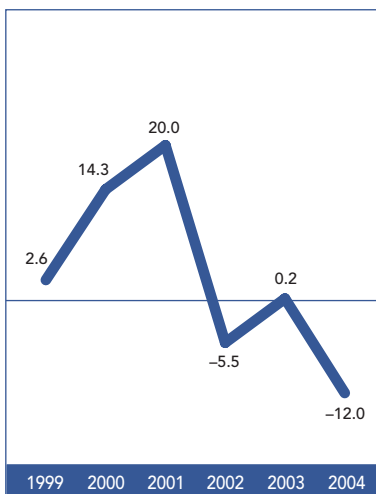
計測機器部門も、日本経済の景気回復が進む中、自動車関連産業を中心に国内の計測機器市況が順調に回復し、売上高は、前年比12.3%増の15,279百万円となりました。

地域別に見ると、国内や韓国が年間をとおして好調に推移しました。上期にSARSの影響があった台湾も下期より急回復し、中国での需要も着実に増加しており、韓国も含めた東アジアへの売上高は前年比53.7%増の16,774百万円と大幅に伸長しました。米国は第4四半期より回復が顕著になってきたものの、前年比24.9%減の5,311百万円となり、欧州は前年比35.8%増の3,838百万円、東南アジア他の地域への売上高は49.4%増の2,983百万円となりました。結果として、海外売上高は、全体の46.4%を占めました。

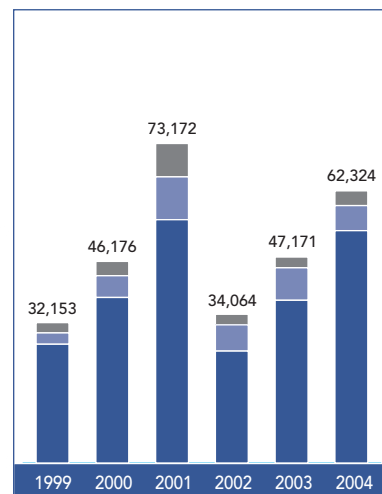
総資産、株主資本
(百万円)



株主資本当期利益率
(%)



売上高(所在地別)
(百万円)



■ 総資産 ■ 株主資本

■ 日本 ■ アメリカ合衆国 ■ ドイツ

【半導体製造装置部門】

既存製品群の主力であるウェーハプロービングマシンは、最先端半導体デバイスや300mmウェーハに対応した高精度な装置への需要が急増し、リピートオーダーに加え、新たなお客様からも受注をいただき、マーケットシェアNo.1を確固たるものとなりました。ウェーハダイシングマシンも、新規顧客増加によりマーケットシェアが拡大した結果、当期の受注高及び3月末受注残高は2000年度の過去最高を上回りました。

新規参入製品群のウェーハ外観検査装置は、低いコスト・オブ・オーナーシップ(CoO)や高い欠陥検出率などがお客様から評価され、既存ユーザーのリピートオーダーと新規ユーザーからの受注を獲得し、マーケットシェアを着実に伸ばしました。

また、ウェーハ薄片化において他に追随を許さない独自製品であるポリッシュ・グラインダは、市場でのデファクトスタンダードとして評価を受け、売上が大幅に伸びました。

さらに、CMP装置は、製品コンセプトや装置の構造の優位性がお客様に浸透し、2003年度の売上高は前年並みに留まりましたが、受注高は倍増し、2004年度の大規模売上増が期待されます。

【計測機器部門】

汎用計測機器では、2003年4月に市場投入した、カールツァイス社の解析・制御技術と当社の高剛性設計技術を融合した三次元座標測定機「ザイザックスSVA」シリーズが高い評

価を受け、販売が大きく伸びました。また、リニアモータ採用で世界最高精度と低振動を実現した表面粗さ・輪郭形状測定機「サーフコム」シリーズや、高精度が好評の真円度測定機「ロンコム」シリーズの売上が堅調に推移しました。

自動計測機器では、自動車産業の設備投資が活発であったことを反映し、自動車の部品生産ライン等で使用されるマシンコントロールゲージ「パルコム」シリーズが好調でした。また新製品の「ATC振れ検出システム」も多くのユーザーの生産現場で標準採用されました。

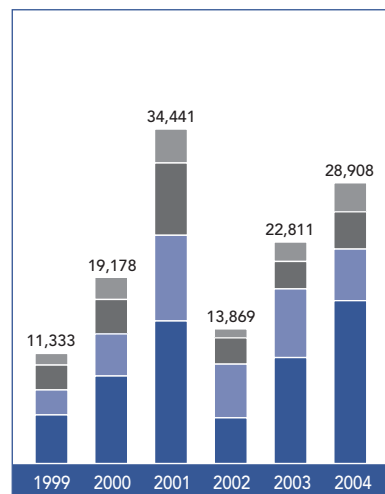
売上原価

2003年度の売上原価は、前年比29.9%増加し46,531百万円となり、売上原価比率は76.0%から74.7%に減少しました。これは、固定費削減、変動費率の引き下げなどのコストダウン施策を推進したことによるものです。

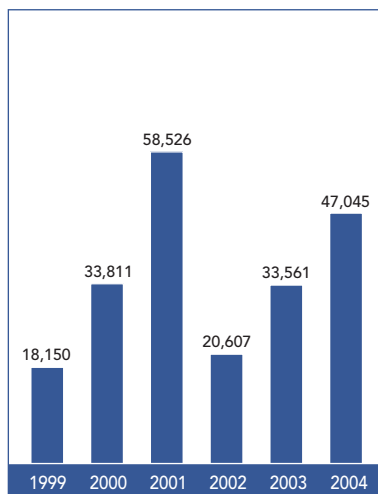
販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、販売費が7,483百万円、一般管理費が2,362百万円となり、合算では前年比3.8%増加し9,846百万円となりました。これは主に売上高の増加に伴うものですが、強力なコストダウン施策が効を奏し、売上高販管費率は2002年度の20.1%から15.7%へと減少しました。

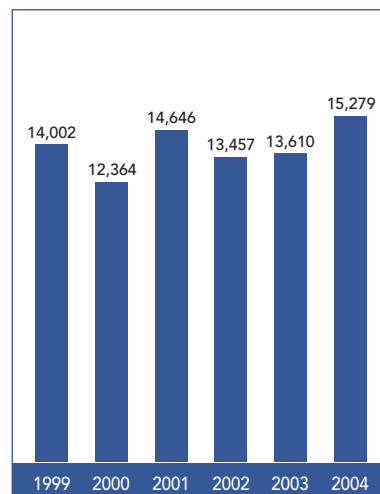
海外売上高
(百万円)



半導体製造装置部門売上高
(百万円)



計測機器部門売上高
(百万円)



■ 東アジア ■ 北アメリカ
■ ヨーロッパ ■ 東南アジア他

営業利益

2003年度は、前年比4,087百万円増の5,947百万円の営業利益を計上し、売上高営業利益率も3.9%から9.5%へと向上しました。

部門別の内訳については、半導体製造装置部門は、前年度は1,022百万円の営業損失でしたが、大幅に改善し2,772百万円の営業黒字を計上しました。また、計測機器部門も、前年比10.1%増の3,174百万円の営業利益を計上し、増益を達成しました。

営業外収益および費用

2003年度の営業外収益は、前年比151百万円減少し、146百万円となりました。また営業外費用は、前年比132百万円減少し、765百万円となりました。

当期純利益

2003年度は、今後の収益基盤を一層拡充するために、CMP事業の再構築とLEEPL事業の収益体質強化を実施し、両事業の開発関連の投資及び費用など9,772百万円を特別損失に計上しました。この主な内訳は、販売用ソフトウェア廃却損3,423百万円やたな卸資産評価損および廃却損3,491百万円、固定資産除却損2,216百万円などです。

この結果、税金等調整前当期純利益は、4,064百万円の損失となり、これより法人税等の税金および少数株主利益等を加減し、当期は3,783百万円の当期純損失となりました。

しかし、当社の配当政策に基づき、一株当たり配当額は前年と同じく30円を維持しています。

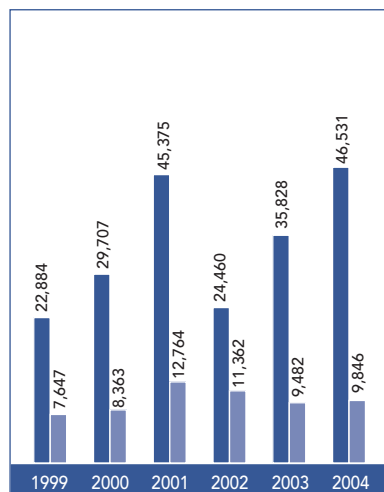
研究開発費

研究開発費は、前年比68.0%増加し、5,530百万円となりました。

半導体製造装置部門では、浜松ホトニクス株式会社と業務提携し、従来のダイシングマシンの常識を覆す新型レーザーダイシングマシン「MAHOHDICING MACHINE」を共同開発しました。この装置は既に受注を獲得し、2004年度には売上に貢献する予定です。

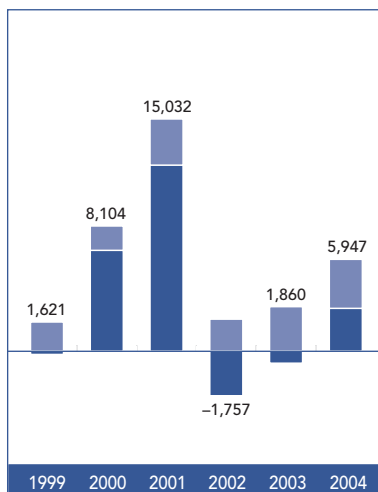
子会社の株式会社リープルが進めている130nmから35nmノードのデバイスに対応する露光装置「LEEPL-3000」の開発も順調で、複数のお客様と本格的な評価を行っており、LEEPL事業が当社のコア事業に成長していくものと予想しています。また、当社が開発しているLEEPLプロセスの一環であるステンシルマスク欠陥検査装置「ESMI 3000」も、計画どおり順調に進捗しており、2004年度に市場投入を予定しています。2001年6月、当社、株式会社リープル、ソニー株式会社の3社が、次世代リソグラフィ技術の開発促進と普及を目的に、各業界に呼びかけて、「LEEPL技術コンソーシアム」を発足させました。当初、半導体デバイスメーカー、装置メーカー、マスクメーカー、レジストメーカーの13社で発足しましたが、その後加入企業が増加し、現在では32社が活動しています。

売上原価、販売費及び一般管理費
(百万円)



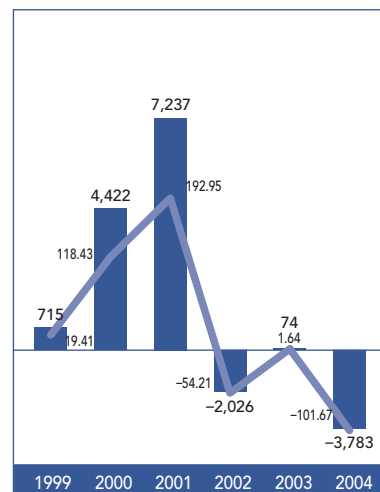
■ 売上原価 ■ 販売費及び一般管理費

営業利益
(百万円)



■ 半導体製造装置部門 ■ 計測機器部門

当期純利益、一株当たり利益
(百万円、円)



■ 当期純利益 ■ 一株当たり利益

計測機器部門では、カールツァイス社製の高精度アクティブスキャニング方式を採用したCNC三次元座標測定機の新シリーズ「ザイザックスSVA fusion」を開発し、2004年4月より販売を開始しました。この装置は、様々な測定物に対して、高精度の寸法測定のみならず、形状検査や位置決めを一台で可能にし、測定・検査時間を大幅に短縮します。

設備投資

設備投資は、前年比24.5%増加し2,904百万円となりました。これは、新製品関連設備への投資が大部分を占めています。また、減価償却費は、前年比6.6%増加し2,749百万円となりました。

為替

当社は、為替に関し、一部北米を除き原則として円建てで取引を行っているため、為替変動によるリスクを低く抑えることが可能となっています。外貨建て取引を行っている米国子会社などに対する売掛金については、為替変動のリスクに備えるため、必要に応じて為替予約取引を利用しています。この取引は実需に基づく為替予約に限定しており、投機目的などのデリバティブ取引は行っておりませんので、リスク管理は正當に遂行されています。

キャッシュ・フロー

2003年度末における現金及び現金同等物は、前年度末より6,049百万円増加し、12,242百万円となりました。

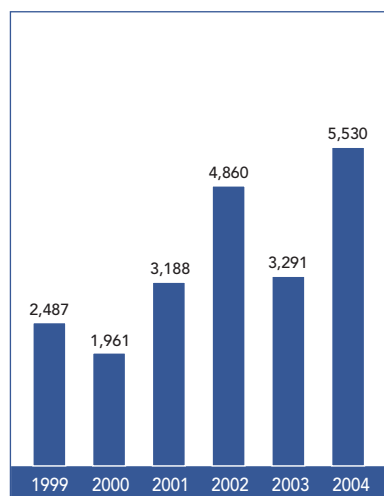
営業活動によるキャッシュ・フローは4,569百万円の収入となりました。これは、当期純損失や10,612百万円の売上債権の増加があったものの、2,829百万円の減価償却費、3,150百万円のたな卸資産の減少及び6,808百万円の仕入債務の増加などによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは167百万円の支出となりました。これは主に1,715百万円の設備投資による支出及び投資有価証券の売却による収入474百万円、有形固定資産の売却による収入1,741百万円などによるものです。

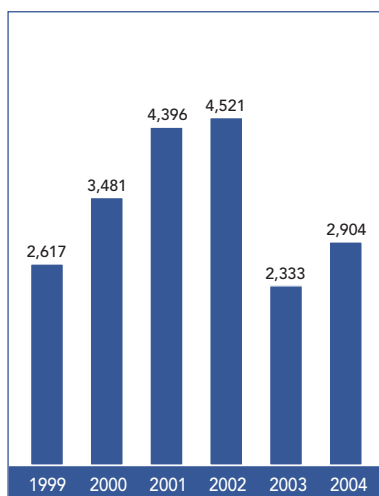
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,662百万円の収入となりました。これは主に、18,000百万円の社債の発行や13,877百万円の短期借入金の返済、1,120百万円の配当金の支払などによるものです。

当期の営業キャッシュ・フローは、前期に比べ大幅に改善されていますが、次期は売上拡大や利益計上などにより、さらに営業キャッシュ・フローの好転が見込まれ、投資活動も平準化することから、より良い財務状況を構築できる見込みです。

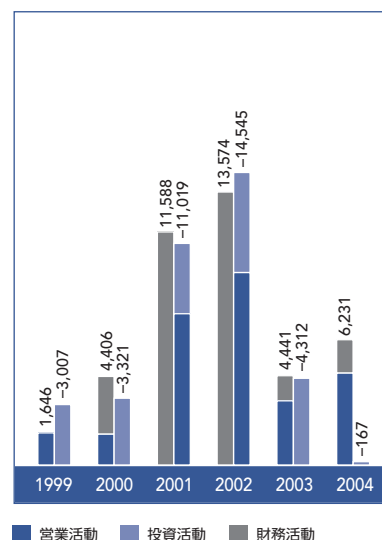
研究開発費
(百万円)



設備投資
(百万円)



キャッシュ・フロー
(百万円)



連結貸借対照表

株式会社東京精密及び連結子会社
2003年及び2004年3月31日現在

資産	百万円		千米ドル (注1)
	2003	2004	2004
流動資産：			
現金及び現金同等物	¥ 6,193	¥ 12,242	\$115,896
預入期間3ヶ月を超える定期預金	27	27	255
受取手形及び売掛金	16,180	26,554	251,394
たな卸資産(注4)	34,075	29,196	276,402
繰延税金資産(注7)	904	2,289	21,678
その他	1,721	675	6,392
貸倒引当金	(40)	(40)	(382)
流動資産合計	59,062	70,944	671,636
有形固定資産：			
土地(注5)	2,919	2,919	27,634
建物及び構築物(注5)	10,159	10,227	96,822
機械装置	7,139	5,823	55,134
建設仮勘定	2,287	719	6,811
その他	3,540	3,662	34,669
	26,044	23,351	221,071
減価償却累計額	(10,466)	(10,504)	(99,442)
有形固定資産合計	15,578	12,847	121,629
無形固定資産：			
ソフトウェア	6,845	3,199	30,291
営業権	622	461	4,373
その他	113	95	902
無形固定資産合計	7,580	3,756	35,567
投資その他の資産：			
投資有価証券(注3)	2,336	3,232	30,597
非連結子会社及び関連会社への投資	159	164	1,561
繰延税金資産(注7)	3,426	3,109	29,436
その他	575	850	8,048
貸倒引当金	(49)	(12)	(121)
投資その他の資産合計	6,447	7,343	69,522
固定資産合計	29,607	23,948	226,719
資産合計	¥ 88,669	¥ 94,893	\$898,355

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

連結損益計算書

株式会社東京精密及び連結子会社
2003年及び2004年3月31日に終了する年度

	百万円		千米ドル
	2003	2004	(注1) 2004
売上高	¥47,171	¥62,324	\$590,027
売上原価	35,828	46,531	440,509
売上総利益	11,343	15,793	149,517
販売費及び一般管理費	9,482	9,846	93,212
営業利益	1,860	5,947	56,304
営業外収益：			
受取利息	7	3	32
その他収益	289	142	1,349
営業外費用：			
支払利息	279	278	2,636
その他費用	618	486	4,610
経常利益	1,259	5,328	50,440
特別利益：			
土地売却益	123	-	-
投資有価証券売却益	-	198	1,879
その他利益	-	182	1,722
特別損失：			
投資有価証券評価損	22	48	455
たな卸資産評価損及び廃却損	903	3,491	33,052
固定資産除却損	-	2,216	20,983
販売用ソフトウェア廃却損	-	3,423	32,408
その他損失	381	593	5,618
税金等調整前当期純利益(純損失)	75	(4,064)	(38,475)
法人税等(注7)：			
当年度分	694	1,044	9,890
法人税等調整額	(908)	(1,598)	(15,130)
	(214)	(553)	(5,239)
少数株主利益	215	273	2,585
当期純利益(損失)	¥ 74	¥ (3,783)	\$ (35,821)

	円		米ドル
			(注1)
一株当り：			
純資産	¥900.32	¥ 780.87	\$ 7.39
当期純利益(損失) — 希薄化前	1.64	(101.67)	(0.96)
— 希薄化後	1.64	-	-
年間配当額	30.00	30.00	0.28

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

連結株主持分計算書

株式会社東京精密及び連結子会社
2003年及び2004年3月31日に終了する年度

	千株	百万円			その他
	株式数	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
2002年3月31日残高	37,370	¥7,199	¥11,806	¥16,463	¥(46)
当期純利益	-	-	-	74	-
為替換算調整勘定	-	-	-	-	(97)
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	(373)
自己株式	(14)	-	-	-	(35)
連結子会社増加による剰余金減少	-	-	-	(212)	-
配当金	-	-	-	(1,121)	-
役員賞与	-	-	-	(12)	-
2003年3月31日残高	37,355	7,199	11,806	15,191	(552)
当期純損失	-	-	-	(3,783)	-
為替換算調整勘定	-	-	-	-	(216)
その他有価証券評価差額金	-	-	-	-	675
自己株式	(1)	-	-	-	(3)
配当金	-	-	-	(1,120)	-
役員賞与	-	-	-	(12)	-
2004年3月31日残高	37,354	¥7,199	¥11,806	¥10,273	¥(97)

	千米ドル(注1)			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	その他
2003年3月31日残高	\$68,162	\$111,774	\$143,814	\$(5,232)
当期純損失	-	-	(35,821)	-
為替換算調整勘定	-	-	-	(2,048)
その他有価証券評価差額金	-	-	-	6,394
自己株式	-	-	-	(32)
配当金	-	-	(10,609)	-
役員賞与	-	-	(121)	-
2004年3月31日残高	\$68,162	\$111,774	\$97,261	\$(918)

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

連結キャッシュ・フロー計算書

株式会社東京精密及び連結子会社
2003年及び2004年3月31日に終了する年度

	百万円		千米ドル
	2003	2004	(注1) 2004
営業活動によるキャッシュ・フロー：			
税金等調整前当期純利益(損失)	¥ 75	¥ (4,064)	\$(38,475)
減価償却費	2,659	2,829	26,786
貸倒引当金の増減	(40)	(35)	(331)
退職給付引当金の増減	233	486	4,609
受取利息及び受取配当金	(143)	(23)	(218)
支払利息	279	278	2,636
投資有価証券評価損	22	48	455
ゴルフ会員権評価損	3	36	340
土地売却益	(123)	-	-
固定資産除却損	-	2,216	20,983
販売用ソフトウェア廃却損	-	3,423	32,408
投資有価証券売却益	-	(198)	(1,879)
売上債権の増減	(4,142)	(10,612)	(100,464)
たな卸資産の増減	(198)	3,150	29,824
仕入債務の増減	6,283	6,808	64,460
その他資産負債の増減	(1,176)	1,388	13,146
役員賞与	(12)	(12)	(121)
小計	3,719	5,721	54,161
利息及び配当金の受取額	143	23	218
利息の支払額	(261)	(290)	(2,754)
法人税等の支払額	(408)	(883)	(8,361)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,193	4,569	43,263
投資活動によるキャッシュ・フロー：			
預入期間3ヶ月を超える定期預金の払込	(20)	(20)	(189)
預入期間3ヶ月を超える定期預金の払出	20	20	189
投資有価証券の取得による支出	(703)	(73)	(693)
関係会社有価証券の取得による支出	(41)	(8)	(79)
投資有価証券の売却による収入	-	474	4,495
有形固定資産の取得による支出	(3,203)	(1,715)	(16,242)
有形固定資産の売却による収入	89	1,741	16,488
無形固定資産の取得による支出	(497)	(262)	(2,484)
その他	43	(324)	(3,071)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(4,312)	(167)	(1,587)
財務活動によるキャッシュ・フロー：			
短期借入金の増減	(3,309)	(13,877)	(131,376)
長期借入れによる収入	5,000	4,100	38,814
長期借入金の返済による支出	(1,284)	(5,235)	(49,568)
社債発行による収入	2,000	18,000	170,406
社債償還による支出	-	(200)	(1,893)
配当金の支払額	(1,121)	(1,120)	(10,609)
その他	(35)	(3)	(32)
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,248	1,662	15,741
現金及び現金同等物の換算差額	40	(16)	(157)
現金及び現金同等物の増加(減少)額	170	6,048	57,259
現金及び現金同等物の期首残高	5,897	6,193	58,637
連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物増加額	125	-	-
現金及び現金同等物の期末残高	¥ 6,193	¥ 12,242	\$ 115,896

添付の注記は連結財務諸表の一部である。

連結財務諸表への注記

株式会社東京精密及び連結子会社

1. 連結財務諸表の基本事項

株式会社東京精密(以下 当社)及びその連結子会社の連結財務諸表は、日本において一般に公正妥当と認められる会計原則に従って作成されている。日本で一般に公正妥当と認められる会計原則は、適用と開示の面で部分的に国際財務報告基準と相違している。添付の連結財務諸表は、日本の証券取引法の規定に準拠して当社が作成した連結財務諸表を国外において一般的な表示様式とするため、表示の組替を行っている。連結財務諸表の注記事項には、日本で一般に公正妥当と認められる会計原則及び慣行では認められていない財務情報が追加的に含まれている。連

結財務諸表上の米ドル金額は、便宜上記載されたものであり、2004年3月31日における実勢為替相場1米ドル=105円63銭で換算されている。換算額は、当該レートまたは他の換算レートにより円貨をドル貨に交換した、または交換できたことを示すものではない。

百万円未満の金額を切り捨てて表示しているため、連結財務諸表上の合計金額(円及び米ドル)は個々の金額の合計値とは必ずしも一致しない。前年度の連結財務諸表に記載された一部の金額は、当年度の表示方法に合わせて組替表示している。

2. 重要な会計方針の要約

(1) 連結の方針

添付の連結財務諸表は2003年及び2004年3月31日における子会社8社を連結している。2003年及び2004年3月31日現在における残りの子会社7社及び関連会社1社は、その総資産、売上高及び利益に重要性がないため連結対象から除いている。

すべての重要な関係会社間の取引、勘定及び未実現利益は消去している。重要性のない関連会社及び非連結子会社への投資は、取得原価あるいはそれ以下の金額で評価されている。当該投資に回復見込みのない減損が生じた場合には、評価減を実施している。剰余金の処分は株主総会決議がなされた期において認識している。

(2) 現金及び現金同等物

現金及び現金同等物は、手許現金、要求払い預金及び短期かつ流動性の高い投資で、取得時において満期が3ヶ月以内の価値変動リスクが僅少なものからなっている。

(3) 有価証券

投資有価証券のうち、時価のあるものについては時価で評価し、その未実現損益は利益の構成要素とはせず、税効果控除後の金額で資本の部の独立項目としている。売却された有価証券の売却原価は移動平均法に基づいて計算している。

投資有価証券のうち、時価のないものについては移動平均法による原価法で評価している。

(4) たな卸資産

当社及び国内の連結子会社のたな卸資産は、仕掛品を除き、先入先出法による原価法を採用している。仕掛品は個別法による原価法によっている。

国外の連結子会社のたな卸資産は先入先出法による低価法で評価している。

(5) 有形固定資産

有形固定資産は取得原価で表示している。当社及び国内の連結子会社における減価償却は各資産毎に見積残存期間に基づき、主として定率法によっている。

国外の連結子会社における減価償却は見積残存期間に基づく定額法によっている。

(6) 無形固定資産

無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した金額で表示している。販売用ソフトウェアは、予定販売数量に対する当期の販売数量の比率ないし残存有効期間に基づく定額法のうち、いずれか大きい金額で減価償却している。自社利用のソフトウェア及びその他の無形固定資産は、それぞれ社内における利用可能期間及び使用可能期間に基づく定額法によっている。

(7) リース

解約不能なリース取引は、原則として、オペレーションリース、ファイナンスリースの区分なくオペレーションリースとして処理している。ただし、リース物件の所有権が移転するリース取引については、ファイナンスリースとして処理している。

(8) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため貸倒引当金を計上している。貸倒引当金は個々の貸倒懸念債権の回収可能性及び過去の貸倒実績に基づき、見積回収不能額を計上している。

(9) 退職給付引当金

退職給付引当金は事業年度末の退職給付債務及び年金資産の見積りに基づき計上している。

数理計算上の差異は、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)にわたり定額法で翌年度から費用処理している。

また、当社及び国内の連結子会社は、全ての取締役及び監査役が貸借対照表日に退任した場合の支給見込額を取締役及び監査役に対する退職慰労引当金として計上している。

(10)外貨換算

当社及び国内の連結子会社における外貨建資産・負債及び国外の連結子会社の財務諸表は日本の外貨建取引の会計基準に従って、以下のように換算している。

a) 当社及び国内連結子会社における外貨建資産・負債

原則として、貸借対照表日の為替レートで円換算している。為替予約によりヘッジされた資産・負債は先物為替予約レートで換算しており、その結果生じる利益又は損失は為替予約の契約期間にわたり配分している。

b) 国外連結子会社の財務諸表

国外の連結子会社の資本を除く資産・負債、収益及び費用は貸借対照表日の為替レートで円換算している。資本項目は取得時又は発生

時の為替レートで円換算している。為替差額は連結貸借対照表上、少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて表示している。

(11)法人税等

繰延税金資産及び負債は、会計上及び税務上の資産・負債の差異に基づいて認識し、当該差異が解消されると見込まれる年度に適用される実効税率及び税法に基づいて計算している。

(12)一株当たり金額

一株当たり純資産は貸借対照表日における発行済株式総数に基づいている。

一株当たり当期純利益(希薄化前)は、各年度の発行済株式総数の加重平均に基づいて計算している。一株当たり当期純利益(希薄化後)は、各年度の発行済株式総数の加重平均に基づいて、転換社債の転換及びワラントの行使があったものと仮定して計算している。

一株当たり配当金は中間配当金と前年度に対する配当金の合計を表示している。

3. 投資有価証券

2003年及び2004年3月31日現在の時価のある有価証券の取得原価及び時価の合計は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
取得原価	¥ 2,533	¥ 2,328	\$ 22,040
時価	1,492	2,448	23,182
未実現利益(損失)	¥(1,040)	¥ 120	\$ 1,142

時価のない有価証券の取得原価の合計は、2003年3月31日現在914百万円、2004年3月31日現在862百万円(8,169千米ドル)である。

4. たな卸資産

2003年及び2004年3月31日現在のたな卸資産は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
商品及び製品	¥ 5,305	¥ 3,885	\$ 36,788
仕掛品	26,816	23,330	220,872
材料及び貯蔵品	1,953	1,979	18,741
	¥34,075	¥29,196	\$276,402

5. 短期借入金及び長期債務

2003年及び2004年3月31日に終了した各事業年度の短期借入金の年間平均利率はそれぞれ0.69%及び0.61%である。2003年及び2004年3月31日現在の長期債務は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
担保付長期債務			
銀行借入			
2003年3月31日現在、返済期限2003年から2007年、利率1.250%から2.100%、 2004年3月31日現在、返済期限2004年から2007年、利率1.250%から2.100%	¥ 5,944	¥ 4,646	\$ 43,992
社債			
利率2.300%、償還期限2006年	150	150	1,420
無担保付長期債務			
銀行借入			
2003年3月31日現在、返済期限2003年から2006年、利率0.600%から1.670%、 2004年3月31日現在、返済期限2004年から2011年、利率0.880%から1.650%	5,800	5,961	56,437
社債			
2003年3月31日現在、償還期限2003年から2008年、利率0.820%から1.230%、 2004年3月31日現在、償還期限2004年から2008年、利率0.820%から1.230%	2,100	2,400	22,720
転換社債			
2003年3月31日現在、利率0.850%、償還期限2008年、 2004年3月31日現在、利率0.000%、償還期限2009年	51	51	482
	-	17,500	165,672
	14,045	30,709	290,726
控除：1年以内に返済期限の到来する額	3,497	4,511	42,709
	<u>¥10,547</u>	<u>¥26,198</u>	<u>\$248,016</u>

2004年3月31日において、全ての未償還の2008年償還期限0.850%転換社債が期末の転換価格1株につき1,818円90銭(17.2米ドル)で転換された場合、28,038株発行される。全ての未償還の2009年償還期限0.000%転換社債が期末の転換価格1株につき5,128円00銭(48.5米ドル)で転換された場合、3,412,636株発行される。

2004年3月31日以降の長期債務(流動部分を含む)の年度別返済予定額は以下のとおりである。

3月31日終了年度	百万円	千米ドル
2005年	¥ 4,511	\$ 42,709
2006年	3,657	34,621
2007年	2,320	21,967
2008年	2,115	20,022
2009年以降	18,105	171,404
	<u>¥30,709</u>	<u>\$290,726</u>

2004年3月31日現在、短期借入金800百万円(7,573千米ドル)、一年内返済予定長期借入金1,947百万円(18,435千米ドル)及び長期債務2,849百万円(26,976千米ドル)に対して担保提供された資産は、土地655百万円(6,201千米ドル)及び建物4,539百万円(42,978千米ドル)である。

6. 退職給付債務

当社は日本の厚生年金保険法に準拠した厚生年金従業員年金基金、非拠出型の税制適格退職年金制度及び退職金制度を採用している。国内子会社は非拠出型の税制適格年金制度及び退職金制度を採用してい

る。2003年及び2004年3月31日に終了した事業年度の退職給付債務、退職給付費用及び退職給付債務等の計算の基礎の内容は以下のとおりである。

(1) 退職給付債務に関する事項

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
退職給付債務	¥7,535	¥7,603	\$71,980
年金資産(退職給付信託を含む)	1,489	2,447	23,173
退職給付引当金	3,107	3,498	33,118
未認識数理計算上の差異	¥2,938	¥1,657	\$15,686

(2) 退職給付費用に関する事項

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
勤務費用	¥341	¥380	\$3,605
利息費用	178	132	1,257
期待運用収益	(18)	(16)	(153)
数理計算上の差異の費用処理額	205	327	3,097
期間純退職給付費用	¥706	¥824	\$7,807

(3) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

	2003	2004
割引率	2.00%	2.00%
期待運用収益率	2.50%	2.50%
退職給付費用の配分方法	定額法	定額法
未認識の数理計算上の差異の償却期間	10年	10年

取締役及び監査役に対する退職慰労引当金の合計は、2003年3月31日現在461百万円、2004年3月31日現在557百万円(5,275千米ドル)である。

7. 税金

当社及び国内の連結子会社は、その所得に対してさまざまな税金が課されており、2003年及び2004年における法定実効税率は合計でそれぞれおよそ42.05%である。国外の連結子会社の法人税等は、全体として当

該国で適用される税率に基づいている。2003年及び2004年3月31日に終了した事業年度の連結損益計算書の実効税率は本来の実効税率とは異なる。その差異の原因となった主な項目は以下のとおりである。

	2003	2004
法定実効税率	42.05 %	42.05%
交際費等の永久差異項目	43.45	(1.09)
住民税均等割	75.77	(1.41)
評価性引当額	(563.72)	(19.89)
在外子会社留保利益	71.51	-
法定実効税率の変更	49.69	(1.36)
その他	(4.43)	(4.68)
実効税率	(285.68)%	13.62%

2003年及び2004年3月31日の主要な繰延税金資産及び負債の項目は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
繰延税金資産：			
退職給付引当金	¥2,188	¥ 2,321	\$ 21,976
未実現利益	1,278	1,006	9,530
繰越欠損金	953	3,238	30,658
その他有価証券評価差額金	426	-	-
未払賞与	207	263	2,497
その他	489	755	7,150
繰延税金資産 小計	5,543	7,585	71,813
評価性引当額	(319)	(1,216)	(11,521)
繰延税金資産	5,224	6,368	60,292
繰延税金負債：			
退職給付信託設定益	(708)	(708)	(6,705)
固定資産圧縮積立金	(105)	(103)	(981)
在外子会社留保利益	(126)	(164)	(1,560)
その他有価証券評価差額金	-	(40)	(385)
繰延税金負債	(939)	(1,017)	(9,632)
繰延税金資産の純額	¥4,284	¥ 5,351	\$ 50,659

8. 株主持分

日本の商法(商法)は取締役会の決議により発行された新株発行価額の少なくとも50%を資本に組み入れることを要求している。資本金に組み入れる額を超過した金額を資本準備金として計上している。

取締役会決議により資本準備金を資本に組み入れることができ、また株主総会決議により配当可能利益に組み入れることができる。

利益剰余金に含まれている利益準備金は商法の規定に従い、利益剰余金処分により積み立てている。この利益準備金は配当に充てることはできないが、株主総会の決議により欠損金の減額または解消に使用することができ、また取締役会の決議により資本に組み入れることができる。

配当金は、その該当する会計年度後に開催される株主総会で決議される。それに加えて、商法の制限に従い、取締役会決議で中間配当を支払うこともできる。

会計年度の間に留保利益から支払われる配当金は、前会計年度の年度末の配当金及び当会計年度の中間配当である。

商法は、資本準備金の額と合わせて資本金の25%に達するまでは利益の処分として支出する金額の10%以上を利益準備金として積み立てることを規定している。また、株主総会決議をもって資本準備金及び利益準備金の合計額より資本金の25%に相当する額を控除した額を限度として資本準備金及び利益準備金を減少させることができるとしている。

9. リースに関する情報

2003年及び2004年3月31日において、オペレーションリース取引として処理されたファイナンスリース取引を、ファイナンスリース取引として処理する場合のリース資産の取得原価及び減価償却累計額並びに帳簿価額は以下のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
機械装置：			
取得価額	¥2,085	¥2,085	\$19,741
減価償却累計額	412	727	6,890
純帳簿価額	¥1,672	¥1,357	\$12,850
その他：			
取得価額	¥ 730	¥ 767	\$ 7,262
減価償却累計額	391	551	5,218
純帳簿価額	¥ 338	¥ 215	\$ 2,044

上記のファイナンスリース取引に関して、2003年及び2004年3月31日に終了した事業年度の支払リース料、各リース期間における残存価額ゼロの定額法により計算された減価償却費相当額及び支払利息相当額は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
支払リース料	¥551	¥570	\$5,396
減価償却費相当額	495	514	4,867
支払利息相当額	88	73	698

オペレーションリース取引として処理しているファイナンスリース取引の将来の支払リース料は次のように要約される。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
1年以内	¥ 479	¥ 270	\$ 2,563
1年超	1,584	1,060	10,039
	¥2,063	¥1,331	\$12,602

10. デリバティブ取引

当社及び連結子会社は、外貨建輸出取引に関連する外国為替レートの変動に備えるための為替予約以外にはデリバティブ取引を行っていない。当社及び連結子会社は将来の貿易取引に関連する為替予約は行わない。当社及び連結子会社は投機目的のデリバティブは保有しない。契約先は国内の高い信用を持った銀行であるため、当社及び連結子会

社、相手先の為替予約契約不履行によるいかなる信用リスクも想定していない。2003年及び2004年3月31日に終了した事業年度の間、当社及び連結子会社は為替予約以外の先物、スワップ、オプション取引は行っていない。

11. 偶発債務

偶発債務は次のとおりである。

	百万円		千米ドル
	2003	2004	2004
受取手形割引高	¥2,383	¥2,456	\$23,254
輸出為替手形割引高	1,039	1,469	13,914

12. セグメント情報

当社及び連結子会社は主として2つの事業セグメントにおいて製品の製造・販売を行っている。

- 1) 半導体製造装置：ウェーハローピングマシン、ウェーハダイシングマシン、ウェーハ外観検査装置、CMP装置、ポリッシュ・グラインダ、リソグラフィ装置、ウェーハ製造装置等
- 2) 精密計測機器：三次元座標測定機、表面粗さ・輪郭形状測定機、真円度測定機、マシンコントロールゲージ等

当社及び連結子会社の2003年及び2004年3月31日に終了した事業年度の事業別セグメント、所在地別セグメント及び海外売上高の概要は以下のとおりである。

(a) 事業別セグメント

2003年3月31日に終了した事業年度				百万円	
	半導体製造装置	計測機器	合計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業収益：					
外部売上高	¥33,561	¥13,610	¥47,171	¥ -	¥47,171
セグメント間の売上高及び振替高	-	-	-	(-)	-
売上高合計	33,561	13,610	47,171	(-)	47,171
営業費用	34,583	10,727	45,311	(-)	45,311
営業利益(損失)	¥(1,022)	¥ 2,882	¥ 1,860	¥ -	¥ 1,860
資産、減価償却費及び資本的支出：					
資産	¥71,158	¥14,303	¥85,462	¥3,207	¥88,669
減価償却費	2,255	323	2,579	-	2,579
資本的支出	2,029	303	2,333	-	2,333

2004年3月31日に終了した事業年度				百万円	
	半導体製造装置	計測機器	合計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業収益：					
外部売上高	¥47,045	¥15,279	¥62,324	¥ -	¥62,324
セグメント間の売上高及び振替高	-	-	-	(-)	-
売上高合計	47,045	15,279	62,324	(-)	62,324
営業費用	44,272	12,104	56,377	(-)	56,377
営業利益	¥ 2,772	¥ 3,174	¥ 5,947	¥ -	¥ 5,947
資産、減価償却費及び資本的支出：					
資産	¥75,630	¥15,805	¥91,435	¥3,457	¥94,893
減価償却費	2,401	347	2,749	-	2,749
資本的支出	2,712	192	2,904	-	2,904

2004年3月31日に終了した事業年度				千米ドル	
	半導体製造装置	計測機器	合計	消去又は 全社	連結
売上高及び営業収益：					
外部売上高	\$445,379	\$144,647	\$590,027	\$ -	\$590,027
セグメント間の売上高及び振替高	-	-	-	(-)	-
売上高合計	445,379	144,647	590,027	(-)	590,027
営業費用	419,130	114,592	533,722	(-)	533,722
営業利益	\$ 26,249	\$ 30,055	\$ 56,304	\$ -	\$ 56,304
資産、減価償却費及び資本的支出：					
資産	\$715,993	\$149,626	\$865,619	\$32,735	\$898,355
減価償却費	22,737	3,291	26,028	-	26,028
資本的支出	25,675	1,819	27,495	-	27,495

(b)所在地別セグメント

						百万円	
2003年3月31日に終了した事業年度	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は 全社	連結	
売上高及び営業収益：							
外部売上高	¥37,268	¥7,440	¥2,462	¥47,171	¥ -	¥47,171	
セグメント間の売上高及び振替高	5,910	-	-	5,910	(5,910)	-	
売上高合計	43,179	7,440	2,462	53,082	(5,910)	47,171	
営業費用	41,299	7,796	2,425	51,521	(6,209)	45,311	
営業利益(損失)	¥ 1,880	¥ (355)	¥ 37	¥ 1,561	¥ 298	¥ 1,860	
資産	¥83,195	¥5,316	¥1,185	¥89,697	¥(1,027)	¥88,669	

						百万円	
2004年3月31日に終了した事業年度	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は 全社	連結	
売上高及び営業収益：							
外部売上高	¥53,210	¥5,738	¥3,375	¥62,324	¥ -	¥62,324	
セグメント間の売上高及び振替高	6,365	-	-	6,365	(6,365)	-	
売上高合計	59,575	5,738	3,375	68,689	(6,365)	62,324	
営業費用	53,804	5,721	3,252	62,779	(6,402)	56,377	
営業利益	¥ 5,770	¥ 16	¥ 122	¥ 5,909	¥ 37	¥ 5,947	
資産	¥89,471	¥6,357	¥1,954	¥97,784	¥(2,891)	¥94,893	

						千米ドル	
2004年3月31日に終了した事業年度	日本	米国	ドイツ	地域合計	消去又は 全社	連結	
売上高及び営業収益：							
外部売上高	\$503,746	\$54,324	\$31,955	\$590,027	\$ -	\$590,027	
セグメント間の売上高及び振替高	60,258	-	-	60,258	(60,258)	-	
売上高合計	564,004	54,324	31,955	650,285	(60,258)	590,027	
営業費用	509,371	54,170	30,795	594,337	(60,614)	533,722	
営業利益	\$ 54,633	\$ 154	\$ 1,159	\$ 55,947	\$ 356	\$ 56,304	
資産	\$847,029	\$60,190	\$18,506	\$925,726	\$(27,370)	\$898,355	

(c) 海外売上高

当社及び国内連結子会社の海外売上高及び海外連結子会社の売上高を含む海外売上高は次のとおりである。

2003年3月31日に終了した事業年度					百万円
	北米	東アジア	ヨーロッパ	その他	連結
海外売上高	¥7,069	¥10,916	¥2,826	¥1,997	¥22,811
連結売上高					47,171
連結売上高に占める海外売上高の割合	15.0%	23.2%	6.0%	4.2%	48.4%

2004年3月31日に終了した事業年度					百万円
	北米	東アジア	ヨーロッパ	その他	連結
海外売上高	¥5,311	¥16,774	¥3,838	¥2,983	¥28,908
連結売上高					62,324
連結売上高に占める海外売上高の割合	8.5%	26.9%	6.2%	4.8%	46.4%

2004年3月31日に終了した事業年度					千米ドル
	北米	東アジア	ヨーロッパ	その他	連結
海外売上高	\$50,287	\$158,807	\$36,341	\$28,244	\$273,681
連結売上高					590,027
連結売上高に占める海外売上高の割合	8.5%	26.9%	6.2%	4.8%	46.4%

13. 後発事象

以下の当社の剰余金の処分は2004年6月29日開催の株主総会で承認された。なお、当該剰余金処分は添付した2004年3月31日に終了した事業年度の連結財務諸表には反映されていない。

	百万円	千米ドル
事業年度末配当金(1株当たり15円=0.14米ドル)	¥560	\$5,304

独立監査人の監査報告書



株式会社東京精密 取締役会 御中

当監査法人は、添付されている株式会社東京精密及び連結子会社の日本円で表示された2003年及び2004年3月31日現在の連結貸借対照表並びに関連する同日をもって終了する各事業年度の連結損益計算書、連結株主持分計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書の監査を行った。これらの財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場からそれらの財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、日本において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社東京精密及び連結子会社2003年及び2004年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する各事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

2004年3月31日をもって終了する事業年度に関して添付されている連結財務諸表における米ドル額は、便宜上表示したにすぎない。当監査法人の監査は、日本円貨額から米ドル額への換算も含んでいる。この換算方法は連結財務諸表の注1の記載に基づいている。

新日本監査法人

2004年6月29日

(注) 上記監査報告書は、海外向け年次報告書に含まれる英文財務諸表に対する英文監査報告書を翻訳したものである。注1において、監査対象の株式会社東京精密及びその連結子会社に係る連結財務諸表の作成方法及び作成の基礎となる日本の会計原則及び会計慣行について説明している。

ネットワーク

日本

株式会社東京精密

本社

〒181-8515
東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422) 48-1011
Fax: (0422) 45-3636

株式会社東精エンジニアリング

本社

〒300-0006
茨城県土浦市東中貫町4-6
Tel: (029) 830-1888
Fax: (029) 830-1881

株式会社アクレーテック・ マイクロテクノロジー

本社

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 60-5225
Fax: (0426) 60-5226

株式会社トーセシステムズ

本社

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 45-1911
Fax: (0426) 45-1942

株式会社アクレーテック・クリエイト

本社

〒181-8515
東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422) 48-1011
Fax: (0422) 49-7068

株式会社アクレーテック・ ファイナンス

本社

〒181-8515
東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel: (0422) 48-1011
Fax: (0422) 42-3816

株式会社リーブル

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 31-9070
Fax: (0426) 42-2370

株式会社東精ボックス

〒192-0032
東京都八王子市石川町2968-2
Tel: (0426) 60-0845
Fax: (0426) 60-0965

北米 米国

Accretech USA, Inc.

Corporate Head Office

2600 Telegraph Rd., Suite 180,
Bloomfield Hills, MI 48302,
U.S.A.

Tel: 1 (248) 332-0100
Fax: 1 (248) 332-0700

SEMICONDUCTOR EQUIPMENT
SECTOR (SES)

Austin Head Office

100 Michael Angelo Way,
Suite D-400,
Austin, TX 78728, U.S.A.

Tel: 1 (512) 246-4500
Fax: 1 (512) 246-4501

Milpitas Office

1765 S. Main Street, Suite 121,
Milpitas, CA 95035, U.S.A.

Tel: 1 (408) 719-2400
Fax: 1 (408) 719-2401

Dallas Office

1810 North Glenville, Suite 124,
Richardson, TX 75081, U.S.A.

Tel: 1 (972) 735-0880
Fax: 1 (972) 735-0890

Boise Office

800 E. Citation Court, Suite A,
Boise, ID 83716, U.S.A.

Tel: 1 (208) 429-6500
Fax: 1 (208) 429-6555

WAFER MANUFACTURING SECTOR
(WMS)

Oakland Head Office

48 Spruce Street,
Oakland, NJ 07436, U.S.A.

Tel: 1 (201) 651-6700
Fax: 1 (201) 651-6701

METROLOGY EQUIPMENT
SECTOR (MES)

Detroit Head Office

39205 Country Club Drive,
Suite C-26, Farmington Hills,
MI 48331, U.S.A.

Tel: 1 (248) 489-5500
Fax: 1 (248) 489-5503

欧州

ドイツ

Tokyo Seimitsu Europe GmbH

Head Office

Landsberger Str. 396,
D-81241 Munich, Germany
Tel: 49 (89) 546788-0
Fax: 49 (89) 546788-10

Dresden Office

Zur Wetterwarte 10,
Geb. 104, EG,
D-01109 Dresden, Germany
Tel: 49 (351) 89024-11
Fax: 49 (351) 89024-12

英国

Tokyo Seimitsu Europe GmbH

Milton Keynes Office

17 Emmett Close,
Milton Keynes, MK4 2DY, U.K.
Tel: 44 (1908) 501710
Fax: 44 (1908) 505642

フランス

Tokyo Seimitsu Europe GmbH

French Office

Le Square A17, Suroit,
48 Avenue du Lac du Bourget,
BP275, 73375 Le Bourget
du Lac Cedex, France
Tel: 33 (479) 26-1541
Fax: 33 (479) 26-1549

イタリア

Tokyo Seimitsu Europe GmbH

Milan Office

Via Roggia Renatella 2/A,
Cernusco s/N, I-20063 Milan,
Italy
Tel: 39 (2) 92112357
Fax: 39 (2) 92111477

イスラエル

Accretech (Israel) Ltd.

Head Office

8 Hasadnaot St.,
P.O. Box 2217,
Hertzeliya B 46120, Israel
Tel: 972 (9) 9574264
Fax: 972 (9) 9574263

アジア

中国

Accretech (China) Co., Ltd.

Head Office

Room 12B08, Marine Tower,
1 Pudong Ave,
Shanghai, China, 200120
Tel: 86 (21) 3887-0801
Fax: 86 (21) 3887-0805

Beijing Office

Kunlun Hotel, Room 331,
2 Xin Yuan Nan Lu,
Chao Yang District, Beijing,
China, 100004
Tel: 86 (10) 6590-3838
Fax: 86 (10) 6590-3818

Shenzhen Office

Room 608, Golden Lustre Hotel,
3002 Chun Feng Road,
Shenzhen, Guangdong
Province, China, 518005
Tel: 86 (755) 2515-7564
Fax: 86 (755) 2515-7574

Chongqing Office

21-FA3, Chongqing
Lanko Hyatt Building,
2 Nanping West Road,
Nanan District, Chongqing,
China, 400060
Tel: 86 (23) 6295-5061
Fax: 86 (23) 6295-5060

Sanmenxia Zhongyuan

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

Head Office

9 Western End of Heping Road,
Sanmenxia, Henan,
China, 472000
Tel: 86 (398) 285-4108
86 (398) 285-4208
Fax: 86 (398) 282-1510
86 (398) 285-4208

韓国

Accretech Micro Technologies Korea Co., Ltd.

59-6 Nonhyun-Dong,
Kangnem-ku, Seoul, Korea
Tel: 82 (31) 287-3016
Fax: 82 (31) 287-3019

台湾

Tokyo Seimitsu Co., Ltd.

Accretech Technical Center Taiwan

5F-1, No. 69, Tze You Road,
Hsinchu, Taiwan
Tel: 886 (3) 531-6633
Fax: 886 (3) 531-3722

マレーシア

Accretech (Malaysia) Sdn. Bhd.

Head Office

39 Jalan PJS 11/2,
46000 Subang Indah,
Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: 60 (3) 5632-7488
Fax: 60 (3) 5632-7489

Penang Office

E-PARSK Block 2A-7-5,
Jalan Batu Uban,
11700 Penang, Malaysia
Tel: 60 (4) 656-1614
Fax: 60 (4) 656-1614

シンガポール

Accretech (Singapore) Pte. Ltd.

10 Ubi, Crescent #05-
92/93/94/95 Lobby E,
Ubi Techpark, Singapore 408564
Tel: 65 (6741) 1712
Fax: 65 (6382) 1123

タイ

Tosei (Thailand) Co., Ltd.

40/14 Moo 12, Bangna Towers C,
16th Floor Bangna-Trad Road
K.M.6.5, Bangkaew, Bangplee,
Samutprakarn 10540, Thailand
Tel: 66 (0) 2751-9563
Fax: 66 (0) 2751-9564

インベスターインフォメーション

本社所在地：

〒181-8515 東京都三鷹市下連雀9-7-1
Tel : (0422) 48-1011
Fax : (0422) 45-3636

設立：

1949年3月28日

資本金：

7,199百万円

従業員数：

連結： 1,100名
個別： 642名

株式：

授權資本： 110,501,100株
発行済株式： 37,372,993株

総株主数：

27,061名

上場証券取引所：

東京証券取引所 市場第一部

大株主：

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)
野村信託銀行株式会社(投信口)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)
株式会社みずほコーポレート銀行
日本精工株式会社
財団法人精密測定技術振興財団
三井生命保険相互会社
株式会社損害保険ジャパン
高城ヒデ子
第一生命保険相互会社

名義書換代理人：

UFJ信託銀行株式会社
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-3

定時株主総会：

毎年6月中 基準日3月31日

独立監査人：

新日本監査法人

お問い合わせ先：

業務会社 IR室
Tel : (0422) 48-1011
Fax : (0422) 45-3636
E-mail : ir@accretech.jp



株式会社東京精密

〒181-8515 東京都三鷹市下連雀9-7-1

Tel : (0422) 48-1011

Fax : (0422) 45-3636

URL : <http://www.accretech.jp>



このアニュアルレポートは再生紙を使用しております。
Printed in Japan